

## 概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽，其全部內容受本文件其他部分出現的更詳細資料及財務資料的限制，並應與之一併閱讀。由於此為概要，其並不包含對閣下可能重要的所有資料，我們強烈建議閣下在作出[編纂]決定之前仔細閱讀整份文件。任何[編纂]均有風險。[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。在閣下決定[編纂]之前，閣下應仔細閱讀該章節。

## 概覽

我們是中國金屬化互連鍍層材料及工藝技術的方案提供商，主要從事製造及銷售鍍層材料以及提供鍍層服務。近20年來，我們一直致力於中國晶圓級及芯片級封裝以及印製電路板（「**PCB**」）製造供應鏈的發展。

十多年來，我們在電子封裝（指用於保護半導體芯片及連接其他元件的工藝與材料）領域經歷了多個行業週期並始終處於技術變革的前沿，展現了優異的市場適應能力及技術升級迭代能力，與產業共同成長。

於往績記錄期間，我們的收入主要來自我們一站式服務解決方案所包含的以下兩大業務分部：

- **鍍層材料業務分部**。這是我們的主要業務，我們通過製造和銷售用於半導體及PCB行業化鍍及電鍍工藝的鍍層材料產生收入。
- **鍍層服務業務分部**。經營該業務分部時，我們向客戶提供硅晶圓（「**硅晶圓**」）、碳化硅晶圓（「**碳化硅晶圓**」）及封裝基板、PCB的化鍍及電鍍鍍層服務，並收取服務費用。

兩大業務板塊聯動強化了我們在行業生態體系中的影響力。具體而言，我們既可以通過承接標準嚴苛的批量生產來補充客戶的生產產能，亦可通過承接關鍵任務（包括新產品及工藝的開發，測試及驗證，以及工程批流片）來有效賦能其研究與開發（「**研發**」）過程。我們不僅讓客戶得以聚焦核心業務，還將自身融入其供應鏈體系，實現可持續發展。

---

## 概 要

---

### 我們的競爭優勢

我們認為以下競爭優勢為我們的成功做出了貢獻，並將我們與競爭對手區分開來，並將在未來繼續支持我們的增長：(i)我們於中國濕製程鍍層材料市場建立穩固地位；(ii)我們擁有以廣泛的行業經驗及強大研發能力為基礎的技術專長；(iii)我們為我們的客戶提供全方位一站式服務解決方案；(iv)我們已建立龐大且優質客戶群體；(v)我們有能力從優質本土供應商享有的供應鏈本土化增長機遇中受益；及(vi)我們具有深刻行業洞察力及遠見卓識的管理團隊。請參閱本文件「業務－競爭優勢」。

### 我們的業務戰略

我們計劃實施以下戰略以取得進一步發展：(i)擴大鍍層材料與鍍層服務產能；(ii)提升研發能力以優化鍍層工藝技術及豐富產品組合；(iii)國際化佈局，構建全球客戶生態體系；(iv)加強銷售團隊建設，拓展客戶覆蓋廣度並深化合作關係深度；及(v)尋求戰略投資及收購，提升產業協同效應。請參閱本文件「業務－戰略」。

### 我們的產品與服務

我們長期從事於半導體及PCB行業濕製程鍍層材料及配套工藝的研究。在電子封裝領域，經過十多年的產品配方及工程經驗積累，我們已成為中國市場中主要的專注金屬化互連的鍍層解決方案提供商。我們已開發出完整的化鍍及電鍍材料產品矩陣，全面覆蓋晶圓級封裝、芯片級封裝及PCB製造的應用場景。我們主要鍍層材料的整體性能已達到國際先進水平，經國家工業信息安全發展研究中心對我們的化學鎳鈀金（「**ENEPIG**」）、化學鎳金（「**ENIG**」）、TSV電鍍銅、無氰電鍍金等關鍵技術指標進行對比後，認可其中多項關鍵性能指標超越全球行業標準。此外，我們的主要半導體客戶亦承認我們產品的關鍵技術指標優於海外可資比較產品。

我們的鍍層材料搭配配套的鍍層工藝，可在不同電子元器件內以原子級精度構建關鍵導電路徑與功能性導電結構，從而實現電信號連接，賦能電子產品完成功能實現。我們的鍍層材料及服務覆蓋應用於半導體及PCB行業的電子封裝領域兩大

---

## 概 要

---

核心鍍層工藝：化鍍與電鍍。具體而言，主要產品包括化學鍍金(ENIG)/化學鍍鈀金(ENEPIG)、電鍍銅及無氰電鍍金鍍層材料。

**化鍍材料：**我們的化鍍材料（包括ENIG/ENEPIG材料）應用於半導體及PCB領域。在半導體行業，我們的鍍層材料及配套工藝主要應用於絕緣閘極雙極型電晶體（「**IGBT**」）、金屬氧化物半導體場效應晶體管（「**MOSFET**」）等功率芯片的晶圓級封裝，互補金屬氧化物半導體圖像傳感器（「**CIS**」）等傳感器芯片封裝，以及集成電路（「**IC**」）載板、玻璃基板及陶瓷基板等封裝基板的芯片級封裝。在PCB行業，我們的鍍層材料及配套工藝主要用於HDI板、高頻高速板、柔性印製電路板（「**FPC**」）及軟硬結合板（「**RFPC**」）等高端PCB的表面金屬化環節。

**電鍍材料：**我們的電鍍材料主要應用於半導體領域，主要產品包括電鍍銅、電鍍金、電鍍鎳、電鍍錫、電鍍錫銀等。相關產品及配套工藝主要用於晶圓級封裝下的硅晶圓、碳化硅晶圓以及芯片級封裝下的玻璃基板及陶瓷基板等封裝基板，能夠滿足半導體製造中不同微觀尺度結構的不同基材表面或孔內的金屬沉積需求，覆蓋Bumping、重佈線層工藝（「**RDL**」）、硅通孔（「**TSV**」）、玻璃通孔（「**TGV**」）等不同金屬化及互連工藝。

**我們的鍍層服務：**為高效且有效地響應下游客戶不斷變化的需求，我們將業務板塊擴展至提供鍍層服務。客戶向我們提供尚未進行鍍層工藝的晶圓和基板（如硅晶圓、碳化硅晶圓、陶瓷及玻璃基板），我們進行鍍層服務後再將成品返還客戶。

我們的鍍層材料及服務廣泛用於下游行業（包括通信電子、數據中心、電動汽車（「**EV**」）及消費電子產品）的電子封裝。請參閱本文件「業務－我們產品及服務的應用」。

## 研發

我們始終將自身定位為濕製程鍍層材料行業的技術驅動型企業，高度重視技術創新與商業化應用。多年來，我們戰略性推進研發工作，持續探索並完善將技術轉化為市場化產品的路徑。於往績記錄期間，我們的累計研發支出達到人民幣119.4百萬元。截至2025年12月31日，我們有73名員工從事研發工作，佔員工總數的15%。我們研

---

## 概 要

---

發團隊的核心成員在電子封裝行業平均擁有超過10年的經驗。我們始終專注於鍍層材料及工藝領域的核心技術，專注於各種固液界面的金屬化及互連技術。通過多年的研發實踐及與客戶的深入合作，我們的技術能力已由PCB製造拓展至晶圓級和芯片級封裝。尤其是，我們之所以能夠提供豐富多樣的核心鍍層材料，源於對化學和材料科學的深刻理解及多年應用技術積累，這使我們能夠攻克複雜的應用挑戰。請參閱本文件「業務－研發－我們的關鍵技術」。

### 製造與生產

憑藉我們豐富的行業經驗和先進的生產技術，我們建立了鍍層材料生產線，該生產線採用高度自動化程序，嚴格的質量控制和ESG合規標準。於往績記錄期間，我們的鍍層材料有兩個生產基地，即創智工廠及智源工廠，以及兩個提供鍍層服務的生產基地，即矽智工廠和創智芯工廠。在2023年之前，我們經營一個生產基地，即智源工廠（該工廠於2013年10月開始商業生產），於2023年，我們暫停其生產，並將鍍層材料生產訂單轉移至創智工廠。智源工廠的利用率於2023年為72.1%。於2023年、2024年及2025年，創智工廠的利用率分別為77.1%、86.7%及98.8%。創智工廠產能及利用率持續提升，主要歸因於產能持續優化升級，以及生產效率提升。有關生產基地及製造流程的詳情，請參閱本文件「業務－製造與生產」。

### 銷售、營銷與分銷

我們制定了以客戶為中心的戰略，覆蓋從客戶獲取到產品及服務交付後服務的整個銷售和營銷生命週期。我們的專業技術服務團隊可直接派駐至客戶生產線，在鍍層材料交付後提供實際操作支持，幫助客戶解決技術問題或滿足定制化需求。除鍍層材料外，我們還可根據客戶要求提供全面指導和定制化說明，包括在客戶的半導體及PCB生產設施現場提供支持，確保客戶充分利用我們的先進技術優化鍍層材料性能。

於往績記錄期間，我們主要直接向中國的終端客戶銷售產品。為了擴大我們產品的地理覆蓋範圍和消費者群體，我們通過分銷網絡來補充直銷業務。我們與分銷商維持買賣關係，除非出現質量問題及經我們事先批准，否則我們一般不允許分銷商退

---

## 概 要

---

貨。截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們分別擁有六名、五名及五名分銷商，彼等分別貢獻我們2023年、2024年及2025年總收入的3.4%、1.4%及1.1%。

### 我們的客戶及供應商

我們的客戶主要包括中國半導體及PCB行業的大型企業。於往績記錄期間，我們的五大客戶於2023年、2024年及2025年分別貢獻人民幣87.6百萬元、人民幣105.1百萬元及人民幣152.0百萬元的收入，分別佔我們同年總收入的28.1%、25.6%及23.9%。此外，於往績記錄期間各年，我們的單一最大客戶分別貢獻同期總收入的8.0%、7.4%及5.1%。據董事所深知，我們於往績記錄期間各年的五大客戶均為獨立第三方。我們的董事、彼等各自的聯繫人或任何股東（據我們的董事所知，於最後實際可行日期擁有我們已發行股本5%以上的權益）概無於往績記錄期間各年於我們的任何五大客戶中擁有任何權益。

我們從第三方供應商處採購原材料及關鍵零部件，包括硫酸鋇、硫酸鎳、二氯四氫鋇、黃金和次磷酸鈉。於往績記錄期間，我們主要從中國內地採購原材料及關鍵零部件，而採購價一般以現行市場價格為準。於往績記錄期間，2023年、2024年及2025年向五大供應商的採購額分別為人民幣83.7百萬元、人民幣155.5百萬元及人民幣263.0百萬元，分別佔我們同年總採購額的63.2%、67.2%及71.2%。此外，於往績記錄期間各期間，我們的單一最大供應商分別貢獻同期總收入的24.6%、23.4%及18.8%。據董事所深知，我們於往績記錄期間各年的五大供應商均為獨立第三方。於往績記錄期間各年，我們的董事、彼等各自的聯繫人或任何股東（據我們的董事所知，於最後實際可行日期擁有我們已發行股本5%以上的權益）概無於我們的任何五大供應商中擁有任何權益。

我們並無向美國客戶進行直接銷售，我們亦無自美國採購原材料。因此，我們並不受中美關稅或相關貿易限制所規限，且該等措施並未對我們的業務運營或財務表現造成任何重大影響。

## 概 要

### 歷史財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期間的財務資料財務數據概要，該等數據摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。下文所載財務數據概要應與本文件所載財務報表（包括相關附註）一併閱讀，以確保其完整性。我們的財務資料乃根據香港財務報告會計準則編製。

### 綜合損益表概要

下表載列於所示年度的經選定綜合損益表：

|                       | 截至12月31日止年度    |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 2023年          | 2024年          | 2025年          |
|                       | 人民幣千元          | 人民幣千元          | 人民幣千元          |
| 收入 .....              | 311,651        | 409,924        | 635,850        |
| 銷售成本.....             | (201,677)      | (234,669)      | (390,175)      |
| <b>毛利 .....</b>       | <b>109,974</b> | <b>175,255</b> | <b>245,675</b> |
| 其他收入及收益 .....         | 4,288          | 3,513          | 5,092          |
| 銷售及分銷開支 .....         | (28,735)       | (34,800)       | (41,474)       |
| 管理費用.....             | (33,292)       | (41,521)       | (64,475)       |
| 研發費用.....             | (30,053)       | (38,823)       | (50,524)       |
| 金融資產和合同資產減值損失淨額 ..... | (903)          | (3,116)        | (9,933)        |
| 其他開支.....             | (515)          | (1,228)        | (6,148)        |
| 財務成本.....             | (1,490)        | (2,065)        | (2,249)        |
| 分佔聯營公司利潤 .....        | —              | 2,957          | 5,697          |
| <b>稅前利潤.....</b>      | <b>19,274</b>  | <b>60,172</b>  | <b>81,661</b>  |
| 所得稅抵免/（開支） .....      | 147            | (7,466)        | (8,451)        |
| <b>年度利潤.....</b>      | <b>19,421</b>  | <b>52,706</b>  | <b>73,210</b>  |
| 以下各項應佔：               |                |                |                |
| 本公司所有者 .....          | 19,421         | 54,448         | 73,763         |
| 非控股權益 .....           | —              | (1,742)        | (553)          |
|                       | 19,421         | 52,706         | 73,210         |

請參閱本文件「財務資料 — 經營業績關鍵組成部分的說明」。

## 概 要

### 收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自(i)銷售用於半導體及PCB行業化鍍及電鍍工藝的鍍層材料；及(ii)提供化鍍及電鍍鍍層服務所收取的服務費。下表載列我們於所示年度按業務線劃分的收入明細，以絕對金額及佔總收入的百分比列示：

|             | 截至12月31日止年度    |              |                |              |                |              |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|             | 2023年          |              | 2024年          |              | 2025年          |              |
|             | 人民幣千元          | %            | 人民幣千元          | %            | 人民幣千元          | %            |
| <b>鍍層材料</b> |                |              |                |              |                |              |
| PCB行業       |                |              |                |              |                |              |
| －化鍍 .....   | 226,357        | 72.6         | 253,805        | 61.9         | 308,256        | 48.5         |
| －電鍍 .....   | —              | —            | —              | —            | 634            | 0.1          |
| 小計 .....    | 226,357        | 72.6         | 253,805        | 61.9         | 308,890        | 48.6         |
| 半導體行業       |                |              |                |              |                |              |
| －化鍍 .....   | 29,113         | 9.4          | 45,905         | 11.2         | 63,929         | 10.1         |
| －電鍍 .....   | 19,455         | 6.2          | 29,129         | 7.1          | 83,383         | 13.1         |
| 小計 .....    | 48,568         | 15.6         | 75,034         | 18.3         | 147,312        | 23.2         |
| 小計 .....    | <b>274,925</b> | <b>88.2</b>  | <b>328,839</b> | <b>80.2</b>  | <b>456,202</b> | <b>71.8</b>  |
| <b>鍍層服務</b> |                |              |                |              |                |              |
| 化鍍及電鍍 ..... | 23,540         | 7.6          | 78,909         | 19.3         | 164,087        | 25.8         |
| 其他* .....   | 13,186         | 4.2          | 2,176          | 0.5          | 15,561         | 2.4          |
| 小計 .....    | <b>36,726</b>  | <b>11.8</b>  | <b>81,085</b>  | <b>19.8</b>  | <b>179,648</b> | <b>28.2</b>  |
| 總計 .....    | <b>311,651</b> | <b>100.0</b> | <b>409,924</b> | <b>100.0</b> | <b>635,850</b> | <b>100.0</b> |

附註：\*在提供鍍層服務的過程中，我們可能會不時及應客戶的要求向客戶提供若干鍍層設備（如電鍍槽），以協助其及時並按照預期的質量標準部署所需量產產能。

請參閱本文件「財務資料－經營業績關鍵組成部分的說明－收入－按業務線劃分的收入明細」。

### 毛利及毛利率

下表載列我們於所示年度按業務分部劃分的毛利及毛利率明細：

## 概 要

|             | 截至12月31日止年度 |      |         |      |         |      |
|-------------|-------------|------|---------|------|---------|------|
|             | 2023年       |      | 2024年   |      | 2025年   |      |
|             | 毛利          | 毛利率  | 毛利      | 毛利率  | 毛利      | 毛利率  |
|             | 人民幣千元       | %    | 人民幣千元   | %    | 人民幣千元   | %    |
| 鍍層材料        |             |      |         |      |         |      |
| PCB行業       |             |      |         |      |         |      |
| －化鍍 .....   | 79,246      | 35.0 | 120,436 | 47.5 | 147,704 | 47.9 |
| －電鍍 .....   | —           | —    | —       | —    | 338     | 53.3 |
| 小計/總計 ..... | 79,246      | 35.0 | 120,436 | 47.5 | 148,042 | 47.9 |
| 半導體行業       |             |      |         |      |         |      |
| －化鍍 .....   | 14,970      | 51.4 | 20,614  | 44.9 | 30,204  | 47.2 |
| －電鍍 .....   | 14,932      | 76.8 | 17,309  | 59.4 | 26,669  | 32.0 |
| 小計/總計 ..... | 29,902      | 61.6 | 37,923  | 50.5 | 56,873  | 38.6 |
| 小計/總計 ..... | 109,148     | 39.7 | 158,359 | 48.2 | 204,915 | 44.9 |
| 鍍層服務 .....  | 826         | 2.2  | 16,896  | 20.8 | 40,760  | 22.7 |
| 總計/總計 ..... | 109,974     | 35.3 | 175,255 | 42.8 | 245,675 | 38.6 |

請參閱本文件「財務資料－經營業績關鍵組成部分的說明－毛利及毛利率」。

## 綜合財務狀況表概要

下表載列我們截至所示日期的綜合財務狀況表概要：

|               | 截至12月31日 |         |         |
|---------------|----------|---------|---------|
|               | 2023年    | 2024年   | 2025年   |
|               | 人民幣千元    | 人民幣千元   | 人民幣千元   |
| 流動資產總額 .....  | 398,504  | 452,993 | 573,144 |
| 非流動資產總額 ..... | 556,866  | 605,922 | 645,340 |
| 流動負債總額 .....  | 88,627   | 125,009 | 189,191 |
| 非流動負債總額 ..... | 45,316   | 39,460  | 31,590  |
| 流動資產淨額 .....  | 309,877  | 327,984 | 383,953 |
| 總權益 .....     | 821,427  | 894,446 | 997,703 |

## 概 要

我們的流動資產淨額由截至2023年12月31日的人民幣309.9百萬元略微增加至截至2024年12月31日的人民幣328.0百萬元，主要是由於(i)應收賬款及應收票據增加人民幣55.5百萬元，(ii)存貨增加人民幣35.9百萬元，及(iii)現金及現金等價物增加人民幣23.7百萬元。該等金額部分被(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產減少人民幣51.3百萬元，(ii)計息貸款及借款增加人民幣16.9百萬元，及(iii)應付賬款及應付票據增加人民幣26.8百萬元所抵銷。請參閱本文件「財務資料－綜合財務狀況表選定項目的討論」。

我們的流動資產淨額由截至2024年12月31日的人民幣328.0百萬元增加至截至2025年12月31日的人民幣384.0百萬元，主要是由於(i)應收賬款及應收票據增加人民幣88.1百萬元、(ii)存貨增加人民幣29.8百萬元及(iii)預付款項、按金及其他應收款項增加人民幣22.9百萬元。該等金額部分被(i)計息銀行及其他借款增加人民幣52.0百萬元、(ii)其他應付款項及應計費用增加人民幣17.8百萬元；及(iii)以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產減少人民幣20.0百萬元所抵銷。請參閱本文件「財務資料－綜合財務狀況表選定項目的討論」。

我們的淨資產由截至2023年12月31日的人民幣821.4百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣894.4百萬元，並進一步增加至截至2025年12月31日的人民幣997.7百萬元，主要由於往績記錄期間各年末淨利潤增加。請參閱本文件附錄一會計師報告的綜合權益變動表。

### 現金流量表概要

下表載列我們於所示年度的現金流量資料概要：

|                        | 截至12月31日止年度 |          |          |
|------------------------|-------------|----------|----------|
|                        | 2023年       | 2024年    | 2025年    |
|                        | 人民幣千元       | 人民幣千元    | 人民幣千元    |
| 經營活動(所用)/所得現金流量淨額..... | 29,201      | 49,985   | (42,086) |
| 投資活動所用現金流量淨額.....      | (59,912)    | (55,483) | (23,784) |
| 融資活動所得現金流量淨額.....      | 22,845      | 29,207   | 69,798   |
| 現金及現金等價物(減少)/增加淨額..... | (7,866)     | 23,709   | 3,928    |
| 截至1月1日的現金及現金等價物.....   | 70,668      | 62,802   | 86,511   |
| 外匯匯率變動的影響(淨額).....     | —           | —        | (80)     |
| 截至12月31日的現金及現金等價物..... | 62,802      | 86,511   | 90,359   |

概 要

請參閱本文件「財務資料－現金流量」。

主要財務比率

下表載列我們於所示年度/截至所示日期的主要財務比率：

|                                 | 截至12月31日/截至該日止年度 |       |       |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|
|                                 | 2023年            | 2024年 | 2025年 |
| 毛利率 <sup>(1)</sup> . . . . .    | 35%              | 43%   | 39%   |
| 淨利潤率 <sup>(2)</sup> . . . . .   | 6%               | 13%   | 12%   |
| 權益回報率 <sup>(3)</sup> . . . . .  | 2%               | 6%    | 8%    |
| 流動比率 <sup>(4)</sup> . . . . .   | 4.50             | 3.62  | 3.03  |
| 資產負債率 <sup>(5)</sup> . . . . .  | 5%               | 6%    | 10%   |
| 債務權益比率 <sup>(6)</sup> . . . . . | 16%              | 18%   | 22%   |

附註：

- (1) 毛利率為根據相應年度的毛利除以收入，再乘以100%計算得出。
- (2) 淨利潤率為根據相應年度的稅後淨利潤除以收入，再乘以100%計算得出。
- (3) 權益回報率為根據相應年度的淨利潤除以權益總額年初及年末結餘的算術平均值，再乘以100%計算得出。
- (4) 流動比率為根據截至相關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算得出。
- (5) 資產負債率為根據截至相關日期的借款總額除以權益總額，再乘以100%計算得出。
- (6) 債務權益比率為根據截至相關日期的債務總額除以權益總額，再乘以100%計算得出。

請參閱本文件「財務資料－主要財務比率」。

競爭格局

由於技術門檻較高，中國濕製程鍍層材料市場參與者數量相對有限，導致整體市場競爭相對集中。以2024年收入計，中國前十大市場參與者佔市場份額63.3%。中國市場參與者可分為國際廠商和國內廠商。得益於在技術研發和產品佈局上的先發優勢，國際廠商過去曾佔據中國濕製程鍍層材料市場。然而，隨著國內廠商技術的快速進步和新產品的不斷推出，少數國內企業已逐漸獲得更多的市場份額。有關我們產品的主要競爭對手的更多詳情，請參閱本文件「行業概覽」一節。

## 概 要

### 風險因素

[編纂]於我們的股份存在若干風險。有關風險因素的詳細討論載於「風險因素」一節。主要風險因素概要載列如下：(i)倘我們未能及時且以具有成本效益的方式開發滿足客戶偏好並獲得市場認可的新產品或服務，我們的經營業績可能受不利影響；(ii)我們依賴使用我們產品的終端市場的增長。該等終端市場的任何增長放緩均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響；(iii)我們的業務增長及前景受我們不斷創新及升級技術及生產流程以及滲透新市場的能力的影響；(iv)濕製程鍍層材料市場競爭激烈。倘我們未能成功競爭，我們的業務、經營業績及未來前景將受到損害；及(v)我們的業務很大程度上取決於我們的管理層及高技能研發人員的努力，如果失去其服務，我們的業務可能受到嚴重干擾。閣下於決定[編纂]前，應完整閱讀本文件「風險因素」一節。

### 股息

於往績記錄期間，本公司並無派付或宣派任何股息。本公司概不保證任何金額的股息將於任何年度宣派或分派。雖然我們目前並無正式的股息政策或固定股息分配比例，但董事會日後可能會在考慮各種因素後宣派股息，包括我們未來的盈利情況及現金流入、未來的資金使用計劃、我們業務的長期發展、法定儲備金、任意儲備金、法律及監管限制以及董事認為相關的其他因素。分派股息將由董事會酌情決定，並須經股東批准。此外，我們的股息政策亦受我們的組織章程細則、中國公司法及任何其他適用中國法律法規所規限。請參閱本文件「財務資料－股息」。

### 我們的控股股東

根據（其中包括）(i)姚先生與(ii)智源芯、智源芯創及智源芯科各自訂立日期分別為2020年8月5日、2020年11月3日及2020年11月3日的一致行動安排，智源芯、智源芯創及智源芯科各自同意與姚先生一致行動，並在行使股東權利（包括但不限於在本公司股東大會上行使表決權）時達成共識。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－一致行動安排」。

截至最後實際可行日期，姚先生（我們的執行董事兼董事長）能夠通過以下股份行使本公司約66.75%的投票權：(i)自身持有的60,107,040股股份，(ii)由前海綠智源持有的1,082,303股股份，該公司為根據中國法律成立的有限公司，且由姚先生及姚博士分別持有75%及20%的權益，(iii)由智源芯持有的8,627,693股股份，該公司為根據中國法律成立的有限合夥企業，且由姚先生作為其執行事務合夥人管理，(iv)由智源芯創持有的3,854,607股股份，該公司為根據中國法律成立的有限合夥企業，以及(v)由智源芯科持有的2,903,835股股份，該公司為根據中國法律成立的有限合夥企業。

## 概 要

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），姚先生將有權行使本公司約[編纂]%的投票權。因此，根據上市規則，姚先生、姚博士、前海綠智源、智源芯、智源芯創及智源芯科將構成本公司的控股股東集團。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。

### [編纂]前投資

本公司獲得[編纂]前投資者的多輪[編纂]，共籌得約人民幣588.9百萬元。有關詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－(1)[編纂]前投資的主要條款」。

### 先前建議A股上市計劃

2023年12月，本公司於2023年12月向中國證券監督管理委員會深圳監管局啟動輔導備案（「輔導備案」），為可能申請上市（「先前上市計劃」）做好準備。於2025年5月，本公司經考慮（其中包括）未來業務的戰略定位及資本規劃後，自願撤回輔導備案。董事確認，並無任何其他與先前上市計劃或輔導備案有關的事宜需要提請聯交所或潛在投資者垂注。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並無注意到任何事項會導致彼等不同意董事就先前上市計劃或輔導備案作出的確認。

### [編纂]統計數字

|                                          | 按[編纂]港元  | 按[編纂]港元  |
|------------------------------------------|----------|----------|
| 股份[編纂] <sup>(1)</sup> .....              | [編纂]百萬港元 | [編纂]百萬港元 |
| 未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值 <sup>(2)</sup> ..... | [編纂]港元   | [編纂]港元   |

附註：

- (1) [編纂]乃基於緊隨[編纂]完成後預期已[編纂]的[編纂]股股份（假設[編纂]未獲行使）計算得出。
- (2) 有關所採用假設和計算方法的進一步詳情，請參閱「附錄二－未經審計[編纂]財務資料」。

## 概 要

### [編纂]用途

我們估計，假設[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及[編纂]以及估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。約[45.0]%（或[編纂]港元）將用於興建及升級我們鍍層材料及鍍層服務的新生產線。約[30.0]%（或[編纂]港元）將用於研發、技術開發、產品升級及產品組合擴展。約[15.0]%（或[編纂]港元）將用於我們未來的潛在策略擴展機遇。約[10.0]%（或[編纂]港元）將用作一般營運資金及一般企業用途。

### [編纂]

截至2025年12月31日，我們已產生[編纂]人民幣[編纂]元，其中(i)約人民幣[編纂]元已於截至2025年12月31日止年度的綜合損益表中扣除及(ii)約人民幣[編纂]元已資本化。按每股[編纂]港元的[編纂]計算並假設[編纂]未獲行使，我們承擔的[編纂]估計為人民幣[編纂]元（[編纂]港元）（包括[編纂]）。其中，(i)[編纂]相關開支，包括[編纂]及其他開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元）；及(ii)非[編纂]相關開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元），包括(a)法律顧問及會計師的費用及開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元）及(b)其他費用及開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元）。我們估計人民幣[編纂]元（[編纂]港元）的[編纂]將計入我們的損益表，人民幣[編纂]元（[編纂]港元）預計將予以資本化。假設每股[編纂]為[編纂]港元且[編纂]未獲行使，則[編纂]佔[編纂]總額的比例為[編纂]%。上述[編纂]為最新可行估計，僅供參考，實際金額可能與該估計有所不同。

### COVID-19疫情的影響

於往績記錄期間，COVID-19疫情對我們的生產運營、物流、供應鏈或業務的其他方面並無造成任何重大不利影響。這主要是因為自2023年起，COVID-19疫情的整體影響已大致消退，且相關管控措施已大幅解除，使我們的運營及業務活動能夠如常進行。

### 近期發展及無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年12月31日（即編製本公司最近期經審計綜合財務資料的日期）起，我們的財務或交易狀況並無重大不利變動，且自2025年12月31日起，概無發生對本文件附錄一會計師報告所載我們的綜合財務報表所示資料產生重大影響的事件。